



FSM-Precision

晶圆翘曲及应力测量系统

FM-SWM

产品功能

- 1、晶圆全场三维翘曲及纳米轮廓测量
- 2、晶圆薄膜应力测量
- 3、晶圆宏观缺陷及薄膜均匀性成像

检测对象

抛光晶圆（硅、砷化镓、碳化硅等），
图形化晶圆，键合晶圆，封装晶圆

面向行业

半导体晶圆生产企业，
半导体制程工艺开发

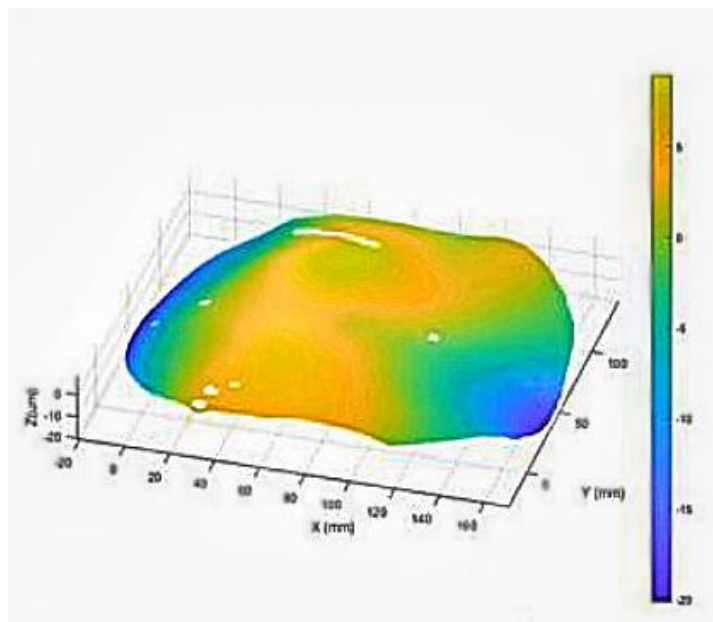
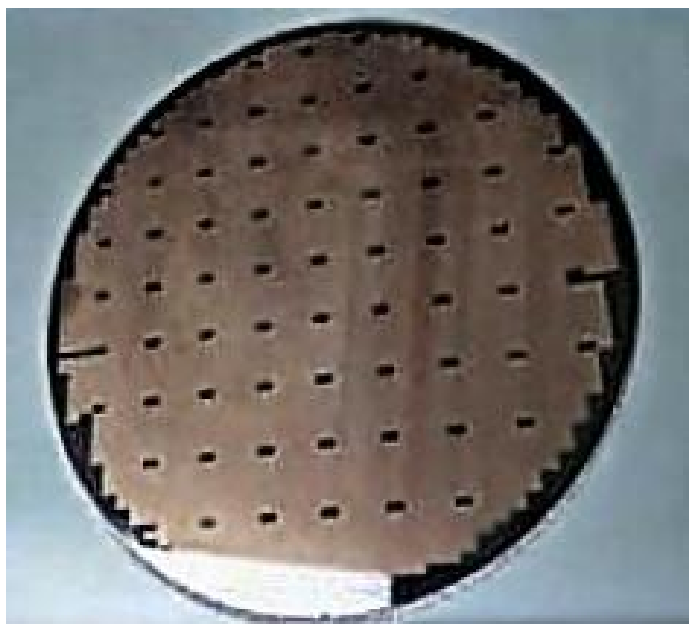


◆ 技术参数

非接触式全场晶圆翘曲测量	测量对象：抛光晶圆，图形化晶圆（圆形，方型，开孔等） 均匀全口径采样，最小采样间隔：0.1mm 检测口径 2 寸 - 8 寸/12 寸全口径（可根据需求调整） 自动输出三维轮廓，曲率，薄膜应力，以及表面瑕疵 测量无需晶圆调平，单次测量时间：10-30s（随采样间隔变化）
三维翘曲	晶圆翘曲量范围：200nm - 10mm（根据晶圆尺寸） 轮廓测量局部分辨率：20nm 轮廓测量重复精度：100nm 低频-高频翘曲软件分析
薄膜表面检测	瑕疵检测：裂纹，麻点，不均匀 裂纹分辨率：50um（分辨率可根据用户需求调整）
薄膜应力测量	测量范围：2MPa - 5000MPa 重复性：2MPa 相对精度：1% 样品温度范围：室温—300 度

◆ 测量实例

1、8 寸图形化晶圆翘曲三维测量



2、表面瑕疵成像

